

 <b>毫欧</b> 毫欧电阻 毫欧制造	<b>HoYH0805 陶瓷合金系列规格书</b>	系列号	HoYH
		修订日期	2019-04-13
		版本号	Ho-A0



# 规格书 Specification

制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoYH

适用: 本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司陶瓷合金电阻 HoYH0805 系列产品选型。

## ■ 产品特点 Features:

陶瓷合金芯片，封体工艺，焊接性能良好

高可靠性，高过载能力，产品精度高。

使用温度范围较宽无感型设计

电阻温度系数  $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C} \leq 100\text{ppm}$

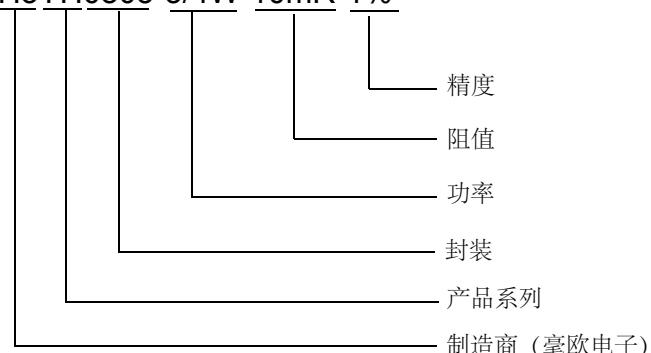
符合 ROHS 要求和无卤要求

## ■ 产品名称 Product Name

陶瓷合金电阻

## ■ 产品型号 Product number

HoYH0805-3/4W-10mR-1%



制造商	产品系列	封装	额定功率(W)	阻值(mR)	精度(%)	温度系数 TCR (ppm)
Ho 毫欧电子	YH 陶瓷合金	0805	3/4W	2mR~9mR	1%	100
				10mR~200mR	0.5%/1%	50

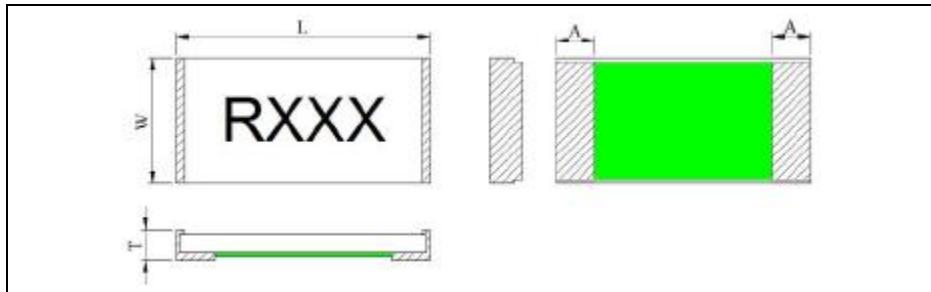


地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼



系列号	HoYH
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

## ■ 产品尺寸 Product Size



产品尺寸：单位 mm

型号	阻值	W	L	T	A
HoYH0805	2mR~3mR	1.35±0.2	2.1±0.2	0.65±0.2	0.65±0.2
	4mR~200mR	1.35±0.2	2.1±0.2	0.65±0.2	0.5±0.2

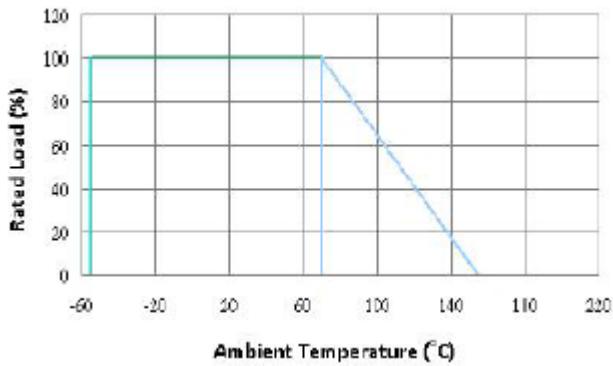
規格外阻值可依客戶需求提供 / We can provide other resistance value per request

## ■ 电气参数 Electrical parameter

额定功率 Rated power	3/4W
阻值范围 Resistance range	2mR~200mR
最大额定电流 Max.Rated Current	1.936A~19.36A
准确度等级 AccuracyClass	0.5%、1%
电阻温度系数 T.C.R ( ppm / °C )	≤50、±100
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55°C~+155°C

## ■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 -55 ~+155 °C 电阻温度达到 70°C 时降功率示意图



在溫度+10°C~40°C、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放 2 年。

在溫度+10°C~60°C、相對濕度為 95%的非露天下最多可存放 30 天。

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

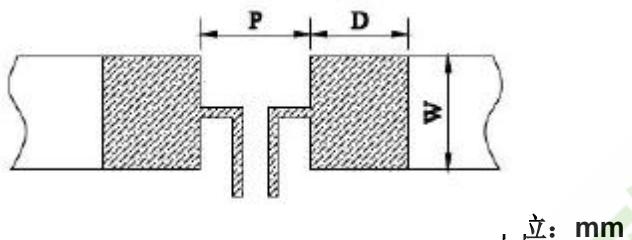
系列号	HoYH
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

■ 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formula

$$I = \sqrt{P/R}$$

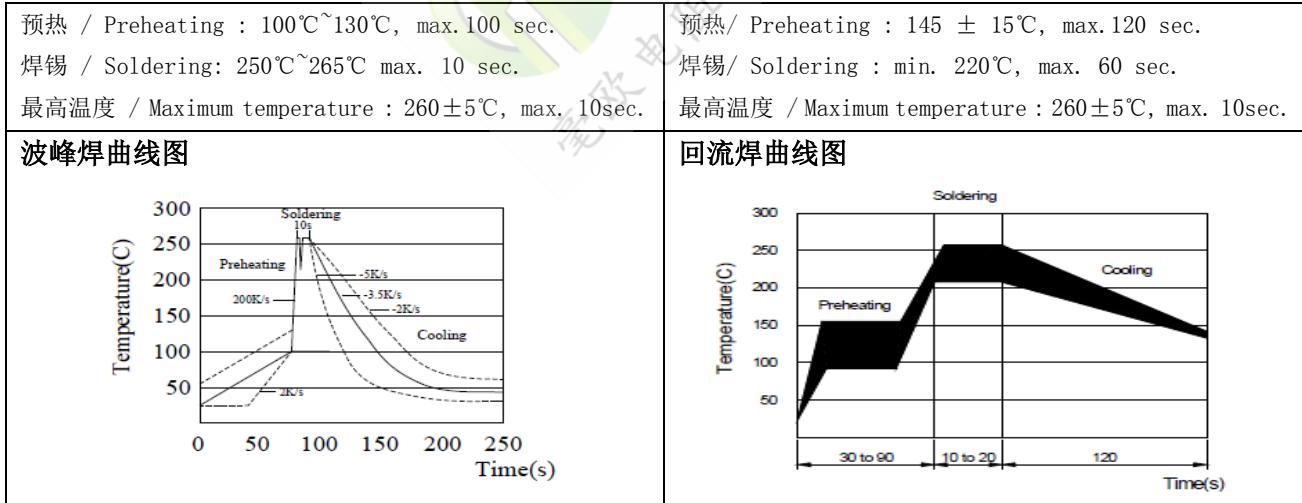
I : Rated Current (A)  
 P: Rated Power (W)  
 R: Resistance Value ( $\Omega$ )

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension



阻值	P	W	D
2mR~3mR	0.5	1.44	1.55
4mR~200 mR	0.8	1.44	1.4

■ 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

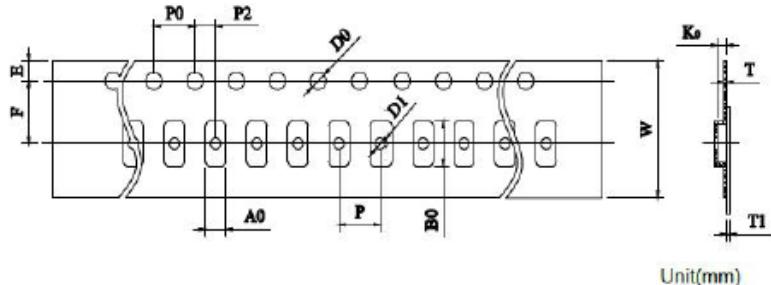


毫欧电阻 毫欧制造

## HoYH0805 陶瓷合金系列规格书

系列号	HoYH
修订日期	2019-04-13
版本号	Ho-A0

## ■ 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)



W	8.00±0.3	P0	4.00 ± 0.1	P	4.00 ± 0.1	P2	2.00 ± 0.1
A0	1.68 ± 0.2	B0	2.38±0.2	D0	1.5 ± 0.1	F	3.50 ± 0.1
E	1.75 ± 0.1	T	0.87 ±0.2	/	/	/	/

## ■ 性能测试 Performance Testing

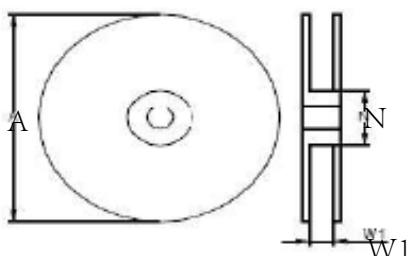
測試方法 Parameter	條件 Conditions	允收標準 Requirements
瞬間過載測試 / Short Time Over Load	P= 2.5Pr ; T=25±2°C , t = 5sec.	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.13
高溫測試 / High Temp. Exposure	T = +170±2°C ; t = 1000h	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
低溫測試 / Low Temp. Storage	T = -55±2°C ; t = 1000h	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
濕度負載壽命測試 / Moisture Load Life (60°C、95% RH)	Vtest = Vmax ; T=60±2°C ; RH=95% ; t= 90min ON , 30min OFF , 1000h	±(2.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
冷熱衝擊測試 / Thermal Shock	[ -55°C 30min. → R.T. 3min. → +150°C 30min. → R.T. 3min ], 100 個連續循環 / 100Cycles	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.19
在 70°C 下負載壽命測試 / Load Life at 70°C	Vtest = Vmax ; T=70±2°C ; t= 90min ON , 30min OFF, 1000h	±(2%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.25
可焊性測試 / Solderability	浸入錫爐 / Dip into solder at T = 245±5°C , t = 3±0.5sec.	錫涵蓋面積/The covered area >95% IEC60115-1 4.17
抗焊熱性測試 / Resistance to Solder Heat	經熱風式迴焊爐 / Through Reflow T= 275±5°C , t=20±1sec.	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.18
機械衝擊測試 / Mechanical Shock	加速度 a =100G , 振幅時間 t =11ms, 5 個衝擊 a =100G , t =11ms, 5 times shock	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.21
基板彎曲測試 / Substrate Bending	兩支撐點間距 / Span between fulcrums : 90mm ; 振幅 / Bend Width : 2mm ; 測試板/Test board : 玻璃纖維板/ Glass-Epoxy Board ; 厚度 / Thickness =1.6mm	±(1.0%+0.5mΩ) IEC60115-1 4.33

## ■ 包装方式 Packing

卷带盘装: 5000pcs/盘

卷带规格

A±5mm	N±2 (mm)	W1±1 (mm)
178	60	9



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼